

## PROGRAMMKOMMISSION

### Vorsitzender der Programmkommission

J. Weber, Zollner Elektronik AG, Zandt

### Wissenschaftlicher Tagungsleiter

M. Nowotnick, Universität Rostock

### Mitglieder

J. Denzel, Airbus Defence and Space GmbH, Ulm  
R. Dietrich, Kempen  
M. Eisenbarth, Conti Temic microelectronic GmbH, Nürnberg  
B. Enser, Semikron International GmbH, Nürnberg  
R. Fiehler, KSG GmbH, Gornsdorf  
H. Fischer, TQ Systems GmbH, Seefeld  
J. Franke, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  
S. Fritzsche, Heraeus Materials Technology, Hanau  
P. Gentschev, Lackwerke Peters GmbH & Co. KG, Kempen  
S. Härter, Siemens AG, Erlangen  
M. Hauer, DYCONEX AG, Bassersdorf, Schweiz  
J. Kostelnik, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Rot am See  
K.-D. Lang, FhG-IZM, Berlin  
D. Müller, VDMA e.V., Frankfurt  
J. Nicolics, Technische Universität Wien, Österreich  
U. Pape, Volkswagen AG, Wolfsburg  
A. Reinhardt, SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim  
T. Scharf, Infineon Technologies AG, Regensburg  
G. Schmitz, Robert Bosch GmbH, Renningen  
R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Frankfurt  
M. Schneider-Ramelow, FhG-IZM, Berlin  
R. Schulze, Neways Electronics Riesa GmbH & Co. KG, Riesa  
H. Schweigart, Dr. O.K. Wack Chemie GmbH ZESTRON, Ingolstadt  
J. Stahr, AT & S AG, Leoben-Hinterberg, Österreich  
S. Uredat, VDE/VDI Innovation + Technik GmbH, Berlin  
M. Weinhold, EIPC, Maastricht, Niederlande  
M. Weinreich, DVS e.V., Düsseldorf  
S. Weinreich, DVS e.V., Düsseldorf  
C. Weiß, ZVEI e.V., Frankfurt am Main  
P. Wild, Rehm Thermal Systems GmbH, Blaubeuren  
J. Wilde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
H. Wohlrabe, Technische Universität Dresden

## KONFERENZSEKRETARIAT

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und  
Feinwerktechnik (GMM)  
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main  
Tel.: 069-6308 - 227  
Fax: 069-6308 - 9828  
E-Mail: gmm@vde.com  
www.ebl-fellbach.de

## PARTNER



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten



Call for Papers

Elektronische  
Baugruppen und  
Leiterplatten

EBL 2020

Technologische Plattform für die  
digitale Transformation

10. DVS/GMM-Tagung

18./19. Februar 2020  
Schwabenlandhalle Fellbach

[www.ebl-fellbach.de](http://www.ebl-fellbach.de)

Titelbild:  
Projekt SWEeT - Siemens Demonstrator (Copyright M. Nowotnick, Uni Rostock)



## ZIELSETZUNG DER TAGUNG

### EBL 2020 Elektronische Baugruppen und Leiterplatten – Technologische Plattform für die digitale Transformation

Die fortschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen, der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze und der Einsatz künstlicher Intelligenz sind aktuelle Themen in der öffentlichen Diskussion über den technischen Fortschritt.

Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass diese Entwicklungen eine technologische Plattform benötigen – elektronische Baugruppen und Leiterplatten, mit denen sich die digitale Transformation auch sicher und effizient realisieren lässt. Deshalb muss die Entwicklung der Baugruppenteknologie vorangetrieben werden, um höhere Frequenzen, Spannungen und Leistungsdichten bei voranschreitender Miniaturisierung und zusätzlicher Integration von Funktionen zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen die Baugruppen aber auch robust, zuverlässig und möglichst kostengünstig sein. Gerade weil der Wettbewerb in der Baugruppenfertigung, vor allem aus Asien, ständig zunimmt, müssen die in Europa dominierenden Branchen, wie z.B. die Medizintechnik oder die Automobilindustrie, auf das Know-how und neueste Technologien für elektronische Baugruppen, die auch in Europa entwickelt werden, aufbauen können.

Die Tagung soll einerseits neue Lösungsansätze zu den genannten Aspekten präsentieren und gleichzeitig zur Diskussion anregen, wie sich diese Innovationen auf die gesamten Systeme auswirken und unter verschiedenen Einsatzbedingungen realisiert werden können. Bei der Vielfalt der Herausforderungen und Entwicklungen ist zu erwarten, dass Vortragende und Teilnehmer aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten wechselseitig zu neuen Erkenntnissen und Ansätzen gelangen. So richtet sich die Konferenz und Fachausstellung „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL“ an erfahrene Experten wie auch Neueinsteiger aus Industrie und Wissenschaft.

Wir sind auf Ihre Beiträge gespannt und freuen uns darauf, Sie 2020 in Fellbach zu treffen.

Johann Weber  
Vorsitzender der  
Programmkommission

Prof. Dr. Mathias Nowotnick  
Wissenschaftlicher  
Tagungsleiter

## THEMEN DER TAGUNG

- Systemkonzepte, Designtools und Simulation
- Neue Materialien
- Funktions- und Schaltungsträger
- Modul- und Baugruppenfertigung
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Prozesssimulation und –steuerung
- Maschinen- und Linienkommunikation
- Prozesssicherheit und Produktprüfung
- Zuverlässigkeit und Analytik
- Packagingtrends

## APPLIKATIONEN

- Automotive
- Consumerelektronik
- Industrieelektronik
- Elektronik für Luft- und Raumfahrt
- Medizintechnik
- Digitale Transformation
- Hochfrequenztechnik
- Kommunikationstechnik
- Leistungselektronik
- Photoniksysteme
- Sensorik
- Sicherheitstechnik

## EINREICHUNG VON BEITRÄGEN

Bitte erstellen Sie ein ca. 200 Wörter umfassendes Abstract. Die Abstracts werden in einem elektronischen Tool gesammelt, das Sie unter

[www.ebl-fellbach.de](http://www.ebl-fellbach.de)

finden.

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- Die Arbeit ist neu und wurde an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht.
- Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit müssen klar beschrieben sein.

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde und erhalten dann eine Schreibanleitung für ihr Manuskript. Das full paper von höchstens sechs Seiten mit vollständigen Autorenangaben reichen Sie dann online als PDF-Datei ein. Bitte verwenden Sie dazu die Rubrik *Einreichung von Beiträgen* auf der Website der Veranstaltung.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Die Teilnehmer der Tagung erhalten vor Tagungsbeginn einen zitierfähigen Tagungsband.

## TERMINE

Deadline für Abstracts	<b>21. Juni 2019</b>
Autorenbenachrichtigung	<b>09. September 2019</b>
Abgabe der Papers	<b>15. November 2019</b>

## TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird Firmen und Instituten die Möglichkeit gegeben, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in einer Tabletop-Ausstellung zu präsentieren. Bitte sprechen Sie uns an und reservieren Sie Ihre Ausstellungsfläche rechtzeitig!